



2026-2032全球与中国AI芯片散热封装市场调研报告

【行业】:软件及商业服务 【报告编码】:179315786803561

【出版时间】:2026-10-28 【订购热线】:+86 180 2246 3983

【电子邮件】:market@winmarketresearch.com

【报告价格】: ¥18900.00 中文电子版
¥18900.00 英文电子版
¥37800.00 中文+英文电子版

内容摘要

根据统计及预测，2025年全球AI芯片散热封装市场销售额达到了23.62亿美元，预计2032年将达到75.24亿美元，年复合增长率（CAGR）为 18.0%（2026-2032）。

本文研究全球及中国市场AI芯片散热封装现状及未来发展趋势，侧重分析全球及中国市场的主要企业，同时对比北美、欧洲、中国、日本、东南亚和印度等地区的现状及未来发展趋势。

AI芯片散热封装是指针对高性能AI处理器、高带宽存储器（HBM）、GPU以及Chiplet异构集成架构，在半导体封装与集成过程中实现芯片互连、电气传输、机械保护和高效热管理的一类先进封装技术。该技术融合先进封装结构、高导热材料、热界面材料、散热结构以及液冷兼容设计，用于解决AI芯片功耗提升、热流密度增加以及系统可靠性下降等问题。本研究对象主要覆盖应用于半导体封装环节的热管理解决方案，服务于AI服务器、高性能计算（HPC）、数据中心、自动驾驶平台以及下一代智能计算系统。

核心总结

AI芯片散热封装主要受AI服务器和高性能计算需求推动

HBM与先进封装技术成为AI散热管理核心发展方向

亚太地区是AI芯片封装制造主要区域

高导热材料和先进散热结构应用持续提升

数据中心AI服务器成为散热封装主要增长领域

行业发展趋势

AI芯片散热封装市场正受到人工智能计算、高性能计算以及高带宽存储需求快速增长推动。随着AI加速器、GPU和HBM堆叠结构持续提升计算性能，传统封装技术面临热流密度提高和散热能力不足的问题。未来先进封装技术将进一步融合2.5D/3D封装、Chiplet架构、混合键合以及高密度互连技术，同时结合高导热材料、热界面技术、嵌入式散热结构和液冷兼容方案，形成面向下一代AI数据中心和高性能计算平台的一体化热管理体系。

市场动态

驱动因素

AI基础设施快速建设、AI服务器部署增加、GPU和HBM需求增长以及半导体性能持续提升是推动AI芯片散热封装发展的主要因素。随着人工智能模型规模扩大和计算任务复杂度提升，芯片功耗不断提高，推动半导体企业、封装企业和材料企业加快先进封装及热管理技术布局。高功率密度芯片的发展进一步促进热界面材料、高导热材料以及创新散热方案的应用。

限制因素

AI芯片散热封装面临制造复杂度高、设备投入大以及工艺协同要求严格等限制因素。先进热管理封装需要对材料性能、界面结构和制造流程进行精确控制，导致生产成本较高，同时先进封装产品需要较长验证周期。高性能AI芯片的热可靠性测试也增加了供应商技术开发难度。

市场机遇

AI数据中心扩张、下一代GPU发展、HBM技术升级以及Chiplet架构普及将为AI芯片散热封装带来持续增长机会。具备高导热材料开发能力、先进封装工艺能力以及系统级散热集成能力的企业，将受益于高性能计算市场需求提升。

行业风险与挑战

行业主要挑战包括超高热流密度管理、封装尺寸与散热性能平衡、制造成本控制以及长期高负载运行可靠性提升。未来AI计算系统的发展需要芯片设计、先进封装技术和散热基础设施之间形成更加紧密的协同。

产业链分析

AI芯片散热封装产业链由上游材料、设备和半导体工艺环节，中游先进封装及热管理解决方案环节，以及下游AI计算应用

环节组成。上游主要涉及热界面材料、高导热散热材料、封装基板材料、半导体设备以及封装工艺技术；中游主要包括先进封装制造、热结构设计、HBM堆叠、Chiplet封装以及液冷兼容型封装方案；下游主要应用于AI服务器、数据中心、自动驾驶系统以及智能电子设备。产业价值主要体现在提升AI芯片计算密度、热可靠性和能源效率。

细分市场分析

AI芯片散热封装可按照散热技术路线、材料类型和应用场景进行划分。其中，先进封装热管理技术是当前最具战略价值的细分方向，主要受2.5D/3D封装、HBM堆叠和Chiplet架构快速发展推动。液冷兼容型芯片封装正在成为新兴方向，以满足未来高功率AI芯片更高散热需求。在材料领域，热界面材料和高导热散热材料的重要性持续提升，其性能直接影响芯片热传导效率和封装可靠性。市场结构正由传统被动散热方案向封装结构、材料技术和冷却系统融合的一体化热管理方案发展。

。

下游市场机会

数据中心AI服务器是AI芯片散热封装最大的下游机会领域，主要受AI加速器、GPU集群以及HBM计算平台快速部署推动。自动驾驶AI芯片和消费电子AI芯片也将持续产生对小型化、高效率散热方案的需求。未来市场机会主要集中于超大规模数据中心、边缘AI计算以及高性能智能系统，这些应用对于更高计算能力和更高热可靠性提出持续需求。

地区分析

亚太地区是AI芯片散热封装制造核心区域，依托成熟半导体产业链、先进封装产能以及完善供应体系，在全球市场中占据重要地位。中国、韩国、日本和中国台湾在半导体封装、存储制造、封装基板以及散热技术领域具有较强产业基础。北美地区在AI芯片设计、半导体创新以及高性能计算平台方面保持竞争优势，欧洲则聚焦特色半导体技术和工业应用。未来区域竞争重点将集中于先进封装能力、材料创新以及AI半导体供应链整合能力。

竞争格局

AI芯片散热封装竞争格局由芯片制造企业、先进封装企业、存储企业以及热管理技术供应商共同构成。Samsung Electronics和SK Hynix在HBM相关技术以及先进半导体集成领域具有较强能力；Amkor Technology、长电科技、通富微电和华天科技等企业在先进封装制造服务领域具有重要地位；Intel持续推进异构集成和高性能计算相关先进封装技术。未来竞争将围绕散热技术创新、先进封装能力、材料体系整合以及支持下一代AI计算架构的综合能力展开。

报告范围

本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业，分析这些企业AI芯片散热封装产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。

主要企业包括：

- Samsung Electronics
- Rapidus
- SK Hynix
- Amkor Technology
- 长电科技
- 通富微电
- 华天科技
- 上海先封科技
- Intel

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

- 传统被动散热封装
- 先进封装热管理技术
- 液冷兼容型芯片封装
- 其他

按照不同材料，包括如下几个类别：

- 热界面材料（TIM）
- 高导热散热材料
- 封装基板材料

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

- 数据中心AI服务器
- 自动驾驶AI芯片
- 消费电子AI芯片
- 其他

重点关注如下几个地区

- 北美
- 欧洲
- 中国
- 日本
- 东南亚
- 印度

章节概要

- 第1章：报告统计范围、产品细分及全球总体规模及增长率等数据
- 第2章：全球不同应用AI芯片散热封装市场规模及份额等

第3章：全球AI芯片散热封装主要地区市场规模及份额等

第4章：全球范围内AI芯片散热封装主要企业竞争分析，主要包括AI芯片散热封装收入、市场份额及行业集中度分析

第5章：中国市场AI芯片散热封装主要企业竞争分析，主要包括AI芯片散热封装收入、市场份额及行业集中度分析

第6章：全球主要企业基本情况介绍，包括公司简介、AI芯片散热封装产品、收入及最新动态等

第7章：行业发展机遇和风险分析

第8章：报告结论

报告目录

1 AI芯片散热封装市场概述

1.1 AI芯片散热封装市场概述

1.2 不同产品类型AI芯片散热封装分析

1.2.1 传统被动散热封装

1.2.2 先进封装热管理技术

1.2.3 液冷兼容型芯片封装

1.2.4 其他

1.2.5 全球市场不同产品类型AI芯片散热封装销售额对比（2021 VS 2025 VS 2032）

1.2.6 全球不同产品类型AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）

1.2.6.1 全球不同产品类型AI芯片散热封装销售额及市场份额（2021-2026）

1.2.6.2 全球不同产品类型AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）

1.2.7 中国不同产品类型AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）

1.2.7.1 中国不同产品类型AI芯片散热封装销售额及市场份额（2021-2026）

1.2.7.2 中国不同产品类型AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）

1.3 不同材料AI芯片散热封装分析

1.3.1 热界面材料（TIM）

1.3.2 高导热散热材料

1.3.3 封装基板材料

1.3.4 全球市场不同材料AI芯片散热封装销售额对比（2021 VS 2025 VS 2032）

1.3.5 全球不同材料AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）

1.3.5.1 全球不同材料AI芯片散热封装销售额及市场份额（2021-2026）

1.3.5.2 全球不同材料AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）

1.3.6 中国不同材料AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）

1.3.6.1 中国不同材料AI芯片散热封装销售额及市场份额（2021-2026）

1.3.6.2 中国不同材料AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）

2 不同应用分析

2.1 从不同应用，AI芯片散热封装主要包括如下几个方面

2.1.1 数据中心AI服务器

2.1.2 自动驾驶AI芯片

2.1.3 消费电子AI芯片

2.1.4 其他

2.2 全球市场不同应用AI芯片散热封装销售额对比（2021 VS 2025 VS 2032）

2.3 全球不同应用AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）

2.3.1 全球不同应用AI芯片散热封装销售额及市场份额（2021-2026）

2.3.2 全球不同应用AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）

2.4 中国不同应用AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）

2.4.1 中国不同应用AI芯片散热封装销售额及市场份额（2021-2026）

2.4.2 中国不同应用AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）

3 全球AI芯片散热封装主要地区分析

3.1 全球主要地区AI芯片散热封装市场规模分析：2021 VS 2025 VS 2032

3.1.1 全球主要地区AI芯片散热封装销售额及份额（2021-2026）

3.1.2 全球主要地区AI芯片散热封装销售额及份额预测（2027-2032）

3.2 北美AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）

3.3 欧洲AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）

3.4 中国AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）

3.5 日本AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）

3.6	东南亚AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）
3.7	印度AI芯片散热封装销售额及预测（2021-2032）
4	全球主要企业市场占有率
4.1	全球主要企业AI芯片散热封装销售额及市场份额
4.2	全球AI芯片散热封装主要企业竞争态势
4.2.1	AI芯片散热封装行业集中度分析：2025年全球Top 5厂商市场份额
4.2.2	全球AI芯片散热封装第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额
4.3	2025年全球主要厂商AI芯片散热封装收入排名
4.4	全球主要厂商AI芯片散热封装总部及市场区域分布
4.5	全球主要厂商AI芯片散热封装产品类型及应用
4.6	全球主要厂商AI芯片散热封装商业化日期
4.7	新增投资及市场并购活动
4.8	AI芯片散热封装全球领先企业SWOT分析
5	中国市场AI芯片散热封装主要企业分析
5.1	中国AI芯片散热封装销售额及市场份额（2021-2026）
5.2	中国AI芯片散热封装Top 3和Top 5企业市场份额
6	主要企业简介
6.1	Samsung Electronics
6.1.1	Samsung Electronics公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
6.1.2	Samsung Electronics AI芯片散热封装产品及服务介绍
6.1.3	Samsung Electronics AI芯片散热封装收入及毛利率（2021-2026）&（百万美元）
6.1.4	Samsung Electronics公司简介及主要业务
6.1.5	Samsung Electronics企业最新动态
6.2	Rapidus
6.2.1	Rapidus公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
6.2.2	Rapidus AI芯片散热封装产品及服务介绍
6.2.3	Rapidus AI芯片散热封装收入及毛利率（2021-2026）&（百万美元）
6.2.4	Rapidus公司简介及主要业务
6.2.5	Rapidus企业最新动态
6.3	SK Hynix
6.3.1	SK Hynix公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
6.3.2	SK Hynix AI芯片散热封装产品及服务介绍
6.3.3	SK Hynix AI芯片散热封装收入及毛利率（2021-2026）&（百万美元）
6.3.4	SK Hynix公司简介及主要业务
6.3.5	SK Hynix企业最新动态
6.4	Amkor Technology
6.4.1	Amkor Technology公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
6.4.2	Amkor Technology AI芯片散热封装产品及服务介绍
6.4.3	Amkor Technology AI芯片散热封装收入及毛利率（2021-2026）&（百万美元）
6.4.4	Amkor Technology公司简介及主要业务
6.5	长电科技
6.5.1	长电科技公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
6.5.2	长电科技 AI芯片散热封装产品及服务介绍
6.5.3	长电科技 AI芯片散热封装收入及毛利率（2021-2026）&（百万美元）
6.5.4	长电科技公司简介及主要业务
6.5.5	长电科技企业最新动态
6.6	通富微电
6.6.1	通富微电公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
6.6.2	通富微电 AI芯片散热封装产品及服务介绍
6.6.3	通富微电 AI芯片散热封装收入及毛利率（2021-2026）&（百万美元）
6.6.4	通富微电公司简介及主要业务
6.6.5	通富微电企业最新动态
6.7	华天科技
6.7.1	华天科技公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
6.7.2	华天科技 AI芯片散热封装产品及服务介绍
6.7.3	华天科技 AI芯片散热封装收入及毛利率（2021-2026）&（百万美元）
6.7.4	华天科技公司简介及主要业务
6.7.5	华天科技企业最新动态
6.8	上海先封科技
6.8.1	上海先封科技公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手

6.8.2 上海先封科技

AI芯片散热封装产品及服务介绍

6.8.3 上海先封科技

AI芯片散热封装收入及毛利率（2021-2026）&（百万美元）

6.8.4 上海先封科技

公司简介及主要业务

6.8.5 上海先封科技

企业最新动态

6.9 Intel

6.9.1 Intel

公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手

6.9.2 Intel

AI芯片散热封装产品及服务介绍

6.9.3 Intel

AI芯片散热封装收入及毛利率（2021-2026）&（百万美元）

6.9.4 Intel

公司简介及主要业务

6.9.5 Intel

企业最新动态

7 行业发展机遇和风险分析

7.1 AI芯片散热封装行业

发展机遇及主要驱动因素

7.2 AI芯片散热封装行业

发展面临的风险

7.3 AI芯片散热封装行业

政策分析

8 研究结果

9 研究方法

与数据来源

9.1 研究方法

9.2 数据来源

9.2.1 二手信息来源

9.2.2 一手信息来源

9.3 数据交互验证

9.4 免责声明

报告图表

表格目录

表 1:

传统被动散热封装主要企业列表

表 2:

先进封装热管理技术主要企业列表

表 3:

液冷兼容型芯片封装主要企业列表

表 4:

其他主要企业列表

表 5:

全球市场不同产品类型AI芯片散热封装销售额及增长率对比（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）

表 6:

全球不同产品类型AI芯片散热封装销售额列表（2021-2026）&（百万美元）

表 7:

全球不同产品类型AI芯片散热封装销售额市场份额列表（2021-2026）

表 8:

全球不同产品类型AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）&（百万美元）

表 9:

全球不同产品类型AI芯片散热封装销售额市场份额预测（2027-2032）

表 10:

中国不同产品类型AI芯片散热封装销售额列表（2021-2026）&（百万美元）

表 11:

中国不同产品类型AI芯片散热封装销售额市场份额列表（2021-2026）

表 12:

中国不同产品类型AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）&（百万美元）

表 13:

中国不同产品类型AI芯片散热封装销售额市场份额预测（2027-2032）

表 14:

热界面材料（TIM）主要企业列表

表 15:

高导热散热材料主要企业列表

表 16:

封装基板材料主要企业列表

表 17:

全球市场不同材料AI芯片散热封装销售额及增长率对比（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）

表 18:

全球不同材料AI芯片散热封装销售额列表（2021-2026）&（百万美元）

表 19:

全球不同材料AI芯片散热封装销售额市场份额列表（2021-2026）

表 20:

全球不同材料AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）&（百万美元）

表 21:

全球不同材料AI芯片散热封装销售额市场份额预测（2027-2032）

表 22:

中国不同材料AI芯片散热封装销售额列表（2021-2026）&（百万美元）

表 23:

中国不同材料AI芯片散热封装销售额市场份额列表（2021-2026）

表 24:

中国不同材料AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）&（百万美元）

表 25:

中国不同材料AI芯片散热封装销售额市场份额预测（2027-2032）

表 26:

全球市场不同应用AI芯片散热封装销售额及增长率对比（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）

表 27:

全球不同应用AI芯片散热封装销售额列表（2021-2026）&（百万美元）

表 28:

全球不同应用AI芯片散热封装销售额市场份额列表（2021-2026）

表 29:

全球不同应用AI芯片散热封装销售额预测（2027-2032）&（百万美元）

表 30:	全球不同应用AI芯片散热封装市场份额预测 (2027-2032)
表 31:	中国不同应用AI芯片散热封装销售额列表 (2021-2026) & (百万美元)
表 32:	中国不同应用AI芯片散热封装销售额市场份额列表 (2021-2026)
表 33:	中国不同应用AI芯片散热封装销售额预测 (2027-2032) & (百万美元)
表 34:	中国不同应用AI芯片散热封装销售额市场份额预测 (2027-2032)
表 35:	全球主要地区AI芯片散热封装销售额: (2021 VS 2025 VS 2032) & (百万美元)
表 36:	全球主要地区AI芯片散热封装销售额列表 (2021-2026) & (百万美元)
表 37:	全球主要地区AI芯片散热封装销售额及份额列表 (2021-2026)
表 38:	全球主要地区AI芯片散热封装销售额列表预测 (2027-2032) & (百万美元)
表 39:	全球主要地区AI芯片散热封装销售额及份额列表预测 (2027-2032)
表 40:	全球主要企业AI芯片散热封装销售额 (2021-2026) & (百万美元)
表 41:	全球主要企业AI芯片散热封装销售额份额对比 (2021-2026)
表 42:	2025年全球AI芯片散热封装主要厂商市场地位 (第一梯队、第二梯队和第三梯队)
表 43:	2025年全球主要厂商AI芯片散热封装收入排名 (百万美元)
表 44:	全球主要厂商AI芯片散热封装总部及市场区域分布
表 45:	全球主要厂商AI芯片散热封装产品类型及应用
表 46:	全球主要厂商AI芯片散热封装商业化日期
表 47:	全球AI芯片散热封装市场投资、并购等现状分析
表 48:	中国主要企业AI芯片散热封装销售额列表 (2021-2026) & (百万美元)
表 49:	中国主要企业AI芯片散热封装销售额份额对比 (2021-2026)
表 50:	Samsung Electronics公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
表 51:	Samsung Electronics AI芯片散热封装产品及服务介绍
表 52:	Samsung Electronics AI芯片散热封装收入及毛利率 (2021-2026) & (百万美元)
表 53:	Samsung Electronics公司简介及主要业务
表 54:	Samsung Electronics企业最新动态
表 55:	Rapidus☒公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
表 56:	Rapidus☒ AI芯片散热封装产品及服务介绍
表 57:	Rapidus☒ AI芯片散热封装收入及毛利率 (2021-2026) & (百万美元)
表 58:	Rapidus☒公司简介及主要业务
表 59:	Rapidus☒企业最新动态
表 60:	SK Hynix公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
表 61:	SK Hynix AI芯片散热封装产品及服务介绍
表 62:	SK Hynix AI芯片散热封装收入及毛利率 (2021-2026) & (百万美元)
表 63:	SK Hynix公司简介及主要业务
表 64:	SK Hynix企业最新动态
表 65:	Amkor Technology公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
表 66:	Amkor Technology AI芯片散热封装产品及服务介绍
表 67:	Amkor Technology AI芯片散热封装收入及毛利率 (2021-2026) & (百万美元)
表 68:	Amkor Technology公司简介及主要业务
表 69:	长电科技☒公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
表 70:	长电科技☒ AI芯片散热封装产品及服务介绍
表 71:	长电科技☒ AI芯片散热封装收入及毛利率 (2021-2026) & (百万美元)
表 72:	长电科技☒公司简介及主要业务
表 73:	长电科技☒企业最新动态
表 74:	通富微电☒公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
表 75:	通富微电☒ AI芯片散热封装产品及服务介绍
表 76:	通富微电☒ AI芯片散热封装收入及毛利率 (2021-2026) & (百万美元)
表 77:	通富微电☒公司简介及主要业务
表 78:	通富微电☒企业最新动态
表 79:	华天科技☒公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
表 80:	华天科技☒ AI芯片散热封装产品及服务介绍
表 81:	华天科技☒ AI芯片散热封装收入及毛利率 (2021-2026) & (百万美元)
表 82:	华天科技☒公司简介及主要业务
表 83:	华天科技☒企业最新动态
表 84:	上海先封科技☒公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手
表 85:	上海先封科技☒ AI芯片散热封装产品及服务介绍
表 86:	上海先封科技☒ AI芯片散热封装收入及毛利率 (2021-2026) & (百万美元)
表 87:	上海先封科技☒公司简介及主要业务
表 88:	上海先封科技☒企业最新动态
表 89:	Intel公司信息、总部、AI芯片散热封装市场地位以及主要的竞争对手

表 90: Intel AI芯片散热封装产品及服务介绍

表 91: Intel AI芯片散热封装收入及毛利率 (2021-2026) & (百万美元)

表 92: Intel公司简介及主要业务

表 93: Intel企业最新动态

表 94: AI芯片散热封装行业发展机遇及主要驱动因素

表 95: AI芯片散热封装行业发展面临的风险

表 96: AI芯片散热封装行业政策分析

表 97: 研究范围

表 98: 本文分析师列表

图表目录

图 1: AI芯片散热封装产品图片

图 2: 全球市场AI芯片散热封装市场规模 (销售额) , 2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)

图 3: 全球AI芯片散热封装市场销售额预测: (百万美元) & (2021-2032)

图 4: 中国市场AI芯片散热封装销售额及未来趋势 (2021-2032) & (百万美元)

图 5: 传统被动散热封装 产品图片

图 6: 全球传统被动散热封装规模及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 7: 先进封装热管理技术产品图片

图 8: 全球先进封装热管理技术规模及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 9: 液冷兼容型芯片封装产品图片

图 10: 全球液冷兼容型芯片封装规模及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 11: 其他产品图片

图 12: 全球其他规模及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 13: 全球不同产品类型AI芯片散热封装市场份额2025 & 2032

图 14: 全球不同产品类型AI芯片散热封装市场份额2021 & 2025

图 15: 全球不同产品类型AI芯片散热封装市场份额预测2026 & 2032

图 16: 中国不同产品类型AI芯片散热封装市场份额2021 & 2025

图 17: 中国不同产品类型AI芯片散热封装市场份额预测2026 & 2032

图 18: 热界面材料 (TIM) 产品图片

图 19: 全球热界面材料 (TIM) 规模及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 20: 高导热散热材料产品图片

图 21: 全球高导热散热材料规模及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 22: 封装基板材料产品图片

图 23: 全球封装基板材料规模及增长率 (2021-2032) & (百万美元)

图 24: 全球不同材料AI芯片散热封装市场份额2025 & 2032

图 25: 全球不同材料AI芯片散热封装市场份额2021 & 2025

图 26: 全球不同材料AI芯片散热封装市场份额预测2026 & 2032

图 27: 中国不同材料AI芯片散热封装市场份额2021 & 2025

图 28: 中国不同材料AI芯片散热封装市场份额预测2026 & 2032

图 29: 数据中心AI服务器

图 30: 自动驾驶AI芯片

图 31: 消费电子AI芯片

图 32: 其他

图 33: 全球不同应用AI芯片散热封装市场份额2025 VS 2032

图 34: 全球不同应用AI芯片散热封装市场份额2021 & 2025

图 35: 全球主要地区AI芯片散热封装销售额市场份额 (2021 VS 2025)

图 36: 北美AI芯片散热封装销售额及预测 (2021-2032) & (百万美元)

图 37: 欧洲AI芯片散热封装销售额及预测 (2021-2032) & (百万美元)

图 38: 中国AI芯片散热封装销售额及预测 (2021-2032) & (百万美元)

图 39: 日本AI芯片散热封装销售额及预测 (2021-2032) & (百万美元)

图 40: 东南亚AI芯片散热封装销售额及预测 (2021-2032) & (百万美元)

图 41: 印度AI芯片散热封装销售额及预测 (2021-2032) & (百万美元)

图 42: 2025年全球前五大厂商AI芯片散热封装市场份额

图 43: 2025年全球AI芯片散热封装第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额

图 44: AI芯片散热封装全球领先企业SWOT分析

图 45: 2025年中国排名前三和前五AI芯片散热封装企业市场份额

图 46: 关键采访目标

图 47: 自下而上及自上而下验证

图 48: 资料三角测定

